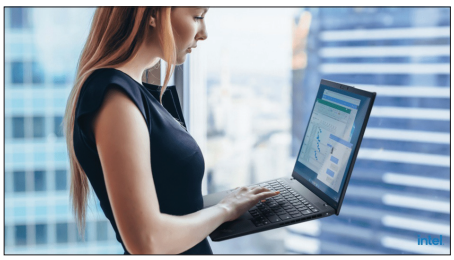
| НОВОСТИ КОМПАНИИ «ГАММА» |

ИИ нового поколения от Lenovo на базе ПЛИС от компании Lattice



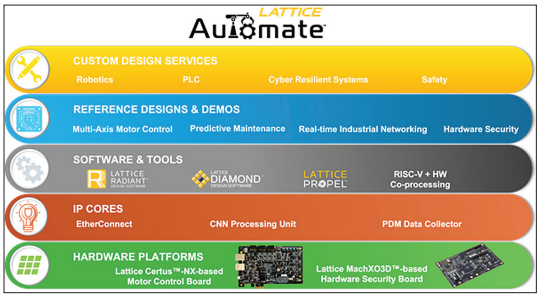
Корпорация Lattice Semiconductor заявила, что ее отмеченные наградами ПЛИС CrossLink-NX и программные решения, оптимизированные для работы искусственного интеллекта, обеспечивают работу устройств Lenovo новейшей серии ThinkPad X1. В новой серии Lenovo ThinkPad используется полностью интегрированное клиентское аппаратное и программное решение от Lattice, предоставляющее пользователям расширенные возможности, включая иммерсивное взаимодействие, конфиденциальность и совместную работу без ущерба для производительности или времени автономной работы.

Комплексное решение Lattice, лежащее в основе новейшей серии ThinkPad X1, состоит из комбинации:

– ПЛИС CrossLink-NX: эти ПЛИС, созданные на основе платформы Lattice Nexus, обеспечивают лучшее в своем классе низкое энергопотребление, малый форм-фактор, надежность и производительность;
– стек решений Lattice sensAI предоставляет готовые к использованию инструменты искусственного интеллекта, машинного обучения, IP-ядра, аппаратные платформы, исходные и демонстрационные проекты, услуги по индивидуальному проектированию и доступ к приложению Glance от Mirametrix, которые ускоряют разработку и вывод на рынок новых передовых устройств.

Расширение возможностей стека решений и инструментов проектирования Automate от Lattice

Корпорация Lattice Semiconductor выпустила новейшую версию своего стека Automate для систем промышленной автоматизации, включающую новые возможности для работы в сети в реальном времени, диагностирование неисправностей на базе искусственного интеллекта, улучшенные производительность и масштабируемость процессора, а также высокую гибкость. Lattice также заявила о выпуске обновленной версии встроенной среды разработки Propel, упрощающей разработку систем промышленной автоматизации с высокой производительностью и дополнительными функциональными возможностями, поддерживающими программное ядро RISC–V.



Усовершенствования и новые функции Automate 1.1:

– взаимодействие между локальной сетью и облаком в режиме реального времени при поддержке отраслевого стандарта OPC UA;
– повышенная производительность процессора и улучшенная масштабируемость;
– более гибкая конфигурация с большим количеством узлов.

Новые функции Propel 2.1:

– поддержка нового ядра RISC–V RV32IMC, обеспечивающего повышенную производительность и расширенную функциональность;
– дополнительные IP-ядра, включая MAC с трехскоростным Ethernet, многопортовый контроллер памяти, 10-Гбит Ethernet и PCIe;
– усовершенствованная встроенная отладка, позволяющая выполнять параллельную отладку процессора и логики с помощью одного кабеля загрузки.

Чипсет WAV600 Series-2 для сертификационного испытательного стенда от MaxLinear

Компания MaxLinear Inc. сообщила, что ее чипсеты SoC WAV600 Series-2 были выбраны в качестве устройств для тестирования точек доступа с целью сертификации в рамках 2-го релиза программы Wi-Fi CERTIFIED 6 альянса Wi-Fi. Для проведения трехдиапазонных испытаний совместимости на частотах 2,4; 5 и 6 ГГц в испытательном стенде используются WAV615 и два Wi-Fi-трансивера WAV665, изготовленных по технологии СнК, от компании MaxLinear.

Этот чипсет обеспечивает основные функции в трех диапазонах частот 2-го релиза стандарта IEEE 802.11ax, который в еще большей мере увеличивает охват, пропускную способность сети на одного пользователя и время автономной работы подключенных клиентских устройств. Это решение разработано для обеспечения быстрого и стабильного подключения домашних Wi-Fi-маршрутизаторов, шлюзов и интеллектуальных расширителей диапазона для кабельной, xDSL, оптоволоконной и потребительской инфраструктуры.

Чипсет MaxLinear WAV600 Series-2 позволяет широкополосным платформам нового поколения обслуживать этот растущий рынок, на котором только в 2022 г. появятся почти 2 млрд устройств Wi-Fi 6.

ПЛИС автомобильного класса Gowin прошли испытания SAIC на термостойкость длительностью 2500 ч

Компании GOWIN Semiconductor и Shanghai Automobile Transmission (SAGW) сообщили о том, что ПЛИС автомобильного класса GOWIN Semiconductor прошли испытания SAIC на термостойкость длительностью 2500 ч, на устойчивость к циклическому нагреву и охлаждению с нагрузкой, испытания на тепловое воздействие, на вибрацию и на пробег 30 тыс. км.

ПЛИС становятся неотъемлемым компонентом при разработке усовершенствованных систем помощи водителю, автономного вождения, лидаров, информационно-развлекательных систем автомобиля и ПО информирования водителя. Производители автомобилей, применяющие ПЛИС в своих разработках, провели независимые сертификационные испытания устройств Gowin AEC-100Q.

SAGW является одним из крупнейших китайских предприятий по производству легковых автомобилей с долей внутреннего рынка около 15%.

Плата сетевой обработки XpressSX AGI-FH400G Agilex I-Series SoC формата PCIe

Плата сетевой обработки XpressSX AGI-FH400G Agilex I-Series SoC формата PCIe основана на ПЛИС Agilex серии I корпорации Intel. Это устройство, оптимизированное для приложений с высокой пропускной способностью, требует высокопроизводительного процессорного интерфейса, поддерживаемого стандартным интерфейсом CXL, интерфейсом PCIe Gen5 x16 и трансиверами со скоростью передачи данных до 116 Гбит/с.

Плата ПЛИС поставляется с активным радиатором шириной в два слота PCIe и специально оптимизирована для использования во встраиваемых системах.

Компании REFLEX CES и CESNET совместно разработали комплексное решение для сетевой безопасности и мониторинга, интеллектуальных сетевых информационных центров и приложений для ускорения работы сетей в рамках проекта Liberouter.

Конфигурация ПЛИС:
- Intel Agilex серии I: AGIB027R29A1E2V;
- СнК (четырехъядерный процессор ARM Cortex A53);
- флэш-конфигурирование;
- концентратор USB 2.0 для JTAG, UART, BMC, USB2.

Память:
- 1× встроенная память DDR4, 64-разрядная шина, 4 Гбайт до 2666 МТ/с;
- 2 разъема DDR4 SO-DIMM, каждый из которых поддерживает до 32 Гбайт SO-DIMM;
- держатель eMMC или SD-карты (если используется) для СнК.

Питание:
- максимальная мощность: 200 Вт, поставляется с активным радиатором шириной в 2 слота;
- питание от слота PCIe и 8-контактного внешнего разъема PCIe Aux ATX (доп. питание).

Рабочая температура: 0–35°C; температура хранения: 0–70°C; размеры платы: полная высота, половинная длина: 167,7×111,15 мм.

Интерфейсы связи:
- PCIe Edge Gen5 ×16;
- совместимость со стандартом CXL:
- открытый стандарт соединения для высокоскоростной передачи данных ЦП–устройство и ЦП–память;
- построен на физическом и электрическом интерфейсах PCIe;
- 8× QSFP56-DD (8× 56G: всего 400G);
- 2 разъема HSI (ARF6–16-L-RA): всего 16 трансиверов для PCIe Gen5 EP/RC, совместимых со стандартом CXL;
- 2 разъема HSI (ARF6–16-L-RA): всего 16 трансиверов для PCIe Gen5 EP/RC;
- 2 разъема USB-C для синхронизующих и управляющих сигналов HSI.

Прочие ресурсы:
- контроллер управления платой (устройство MAX10);
- программируемая ФАПЧ.

Дополнительную информацию и опытные образцы можно получить в ООО «Гамма Плюс»

ГАММА

Выборг: +7 (81378) 546-53;
Москва: +7 (495) 788-1292;
Санкт-Петербург: +7 (812) 321-6160;
Екатеринбург: +7 (343) 286-7512;
Ульяновск: +7 (8422) 256-939;
info@icgamma.ru, www.icgamma.ru